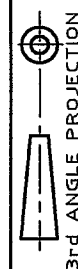


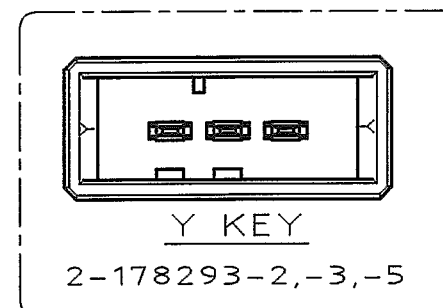
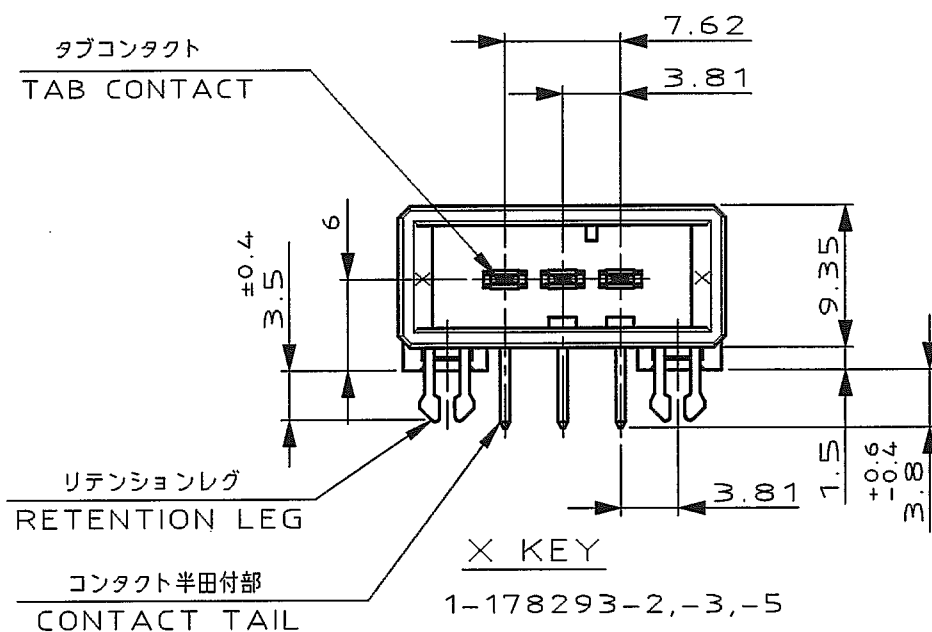
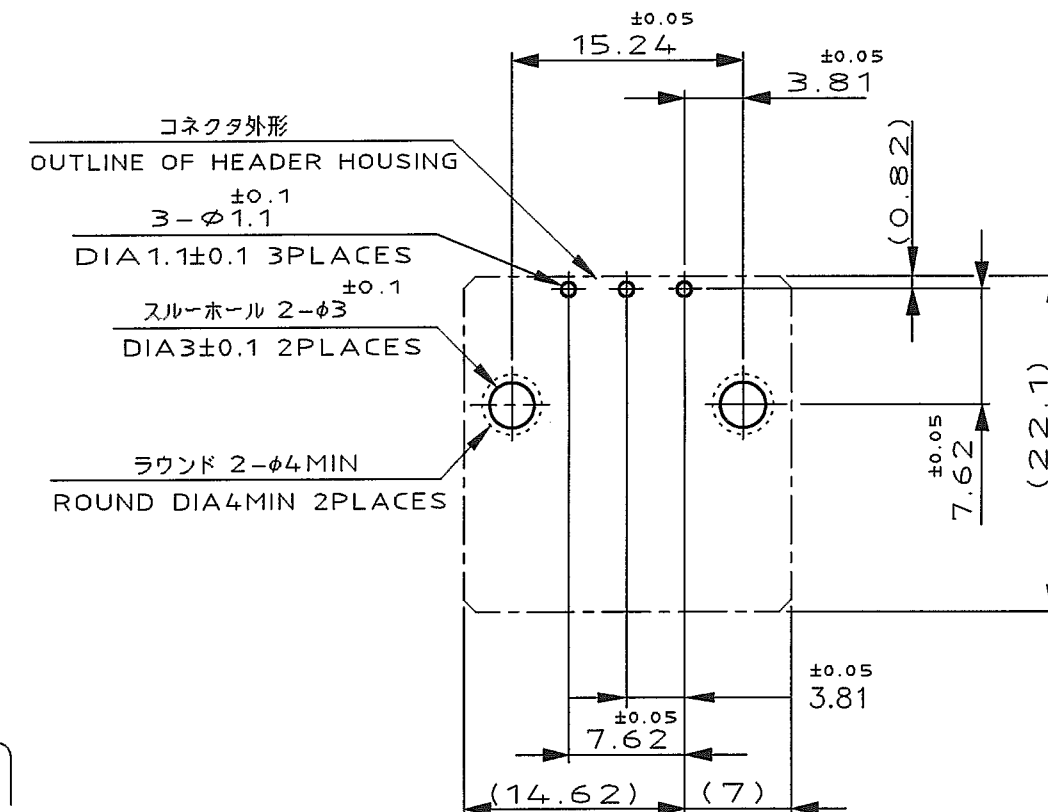
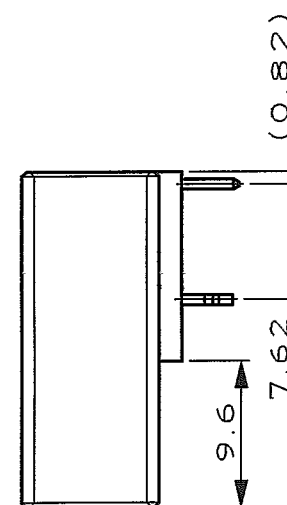
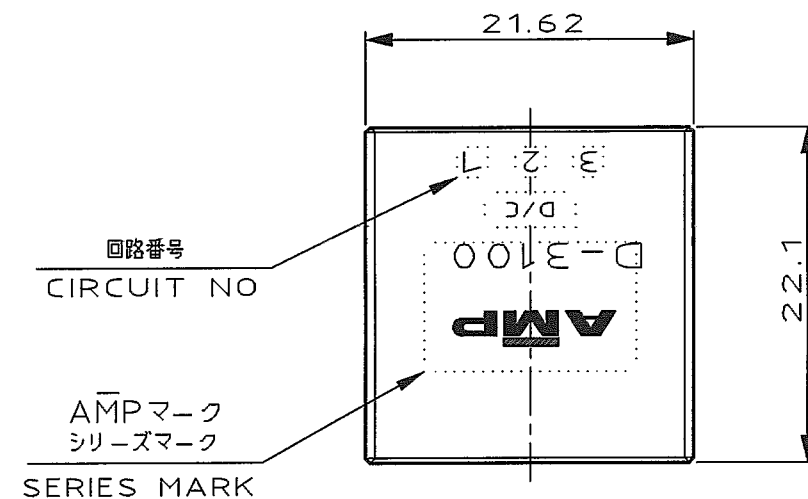
NUMBER 178293



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO
PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY

2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN
PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金

2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の土にスズめっき

6	4	1,2-178293-5
6	3	1,2-178293-3
6	2	1,2-178293-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	14APR 11	DR.	20/MAR/95	DE.	20/MAR/95	CHK.	23/MAR/92	APP.	23/MAR/92
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK.	23/MAR/92	APP.	23/MAR/92				

WIRE RANGE	INSULATION DIA
mm (AWG -)	mm
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照
DR. 20/MAR/95 K.IKEDA	DE. 20/MAR/95 K.IKEDA
CHK. 23/MAR/92 S. MANABE	APP. 23/MAR/92 S. MANABE

3 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	NUMBER
10mm : ±0.3 10mm 3mm : ±0.4 30mm 100mm : ±0.5 角度 : ±3°	A3	J	C=178293
SCALE	REV.	C1	SHEET
2-1			1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面